

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2026-032

科博达技术股份有限公司

关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会于 2026 年 5 月 27 日 15:00-17:00，在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以视频录播和网络互动的方式召开，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2026 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2026-029）。

2026 年 5 月 27 日，公司董事长兼总裁柯桂华先生、董事会秘书赵泽元先生、财务负责人朱迎春女士、独立董事吕勇先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题 1：请介绍下公司全球化相关布局及进展情况？

回复：在境外产能布局上，公司 2023 年在日本设立第一个境外工厂，并于当年底顺利投产。2025 年，我们完成捷克工厂收购，随即推进团队与业务整合。目前，捷克工厂已先后通过大众、宝马、保时捷三大国际车企的体系审核，为后续订单落地与量产交付奠定了坚实基础。

2026 年，公司将着力提升捷克工厂规模化生产能力，增强产品在欧洲市场的综合竞争力。凭借欧洲市场多年积淀的客户资源与运营经验，构建集产品研发、

生产制造、售后交付于一体的海外运营体系，推动海外业务实现从布局落地到高效运营的升级，巩固全球化发展优势。

问题 2：捷克工厂目前是否已量产？预计何时贡献收入？

回复：捷克工厂是科博达全球化战略的重要布局，2025 年 8 月完成收购交割，随后快速完成团队融合、产线建设与试生产；2025 年 11 月 LSG5 产品首件下线；2026 年上半年，工厂连续通过大众、宝马、保时捷的严格审核并全部获得绿灯，具备欧洲高端客户量产资质。相关产品预计 2026 年上半年逐步启动量产，并开始贡献收入。

问题 3：2026 年公司预计哪些品类会实现较为显著的业绩提升？此外，除了既有业务，公司在新品类或新产品方面有哪些布局？

回复：公司将持续夯实经营基础、优化资源配置，依托“全球化 + 智能化”双轮驱动，推进高质量发展。产品端持续加大中央计算平台、域控制器、智慧能源、智能照明等品类的研发投入与市场拓展。2026 年相关业务数据，请以公司定期报告为准。

问题 4：科博达智能科技的客户合作与项目推进情况怎么样？

回复：科博达智能科技聚焦汽车中央计算平台和智驾域控产品，核心客户包括国际主流车企、国内合资品牌及国内自主品牌等，目前科博达智能科技已获得 4 家国内、国际主流品牌车企的定点，其中 3 家车企相关产品已实现规模化量产，定点项目生命周期销售额预计超 200 亿元。

问题 5：公司跟吉利集团哪些子品牌及有哪些零部件产品的合作？预计 26 财年营收情况？

回复：目前，科博达与吉利集团旗下吉利、极氪、极越等多个子品牌均建立了合作关系。产品方面，主要涵盖智能保险丝盒 Efuse、主动进气格栅 AGS、底盘控制器、电磁阀、USB 等核心零部件。2026 年度，伴随吉利相关车型项目放量，预计营收将实现稳步增长。

问题 6：公司可转债当前进度如何？

回复：公司可转债已取得证监会注册批复，当前正推进发行筹备工作，批复有效期为 12 个月。后续公司将结合市场环境择机启动发行，并根据项目实际进

展，严格依照监管规定及时履行信息披露义务。

问题 7：公司 2026 年第一季度终端客户结构如何？

回复：2026 年第一季度，公司前五大终端客户合计营收占比 52.29%，其他客户营收占比提升至 47.71%。具体来看，前五大客户包括德国大众、一汽集团、蔚来汽车、理想汽车、雷诺汽车。

问题 8：公司 2026 年第一季度净利润同比下降的主要原因？

回复：2026 年第一季度净利润同比下滑，主要系人民币升值产生约 3200 万元汇兑损失；同时公司持续加大研发投入，研发费用同比增长 26%。此外，智驾域控等新品尚处于产能爬坡阶段，整体毛利水平阶段性偏低，多重因素共同影响了当期利润表现。

问题 9：公司 2026 年主要资本支出项目有哪些？

回复：根据预算，2026 年公司合并资本支出计划约 5.6 亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备购置支出、产线建设等。

问题 10：2026 年部分芯片等产品面临涨价，公司的原材料成本情况如何？

回复：自 2026 年以来，车规芯片等原材料价格上行，对公司产品成本形成一定压力。对此，公司通过与头部半导体供应商签订长期合作协议、开展战略备货、推进 BOM 优化等方式，积极对冲成本上涨带来的影响，综合来看，公司整体成本风险处于可控范围。

问题 11：公司未来对于分红的预期和规划？

回复：公司制定了 2025-2027 年三年股东回报规划，在保障公司长远发展的前提下，持续维持稳定的现金分红水平，积极回报广大股东。2025 年度现金分红方案已确定并将按计划于 6 月 1 日实施。

此外，经 2025 年年度股东会授权，在经营、现金流等条件满足的情况下，公司将择机开展中期分红。

问题 12：公司去年股权激励计划到期后，有无新的激励计划？

回复：公司始终重视核心人才的激励与绑定，并结合战略规划、经营情况与人才梯队需求，对包括股权激励在内的长效激励工具进行研究与论证。截至目前，公司暂无应披露未披露的股权激励计划或具体时间表。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年5月28日